

ともに歩む、その先の革新へ



イビデン株式会社

2026 年 3 月期(2025 年度) 中間決算説明会

2025 年 10 月 31 日(金)

イベント概要

[企業名] イビデン株式会社

[証券コード] 4062

[イベント言語] JPN

[イベント種類] 決算説明会

[イベント名] 2026 年 3 月期 中間決算説明会

[開催日] 2025 年 10 月 31 日(金)

[開催時間] 10:00～11:00 (合計 1 時間：説明 20 分、質疑応答 40 分)

[開催場所] インターネット配信

[登壇者] 3 名

代表取締役社長

河島 浩二

経営役員 経営企画本部長

宮崎 信治

幹部職 経営企画部長

廣瀬 康人

2026 年 3 月期 中間決算説明会 主な質疑応答

< 質問者 1 >

- [Q] 今回の決算のポイントの 1 つとして、ASIC^{*1}の立ち上りが想定以上に早いという印象だが、Q4 時点および 2026 年度の ASIC の売上規模を教えてください。また、ASIC 向けの IC パッケージ基板にはどのような技術が必要となり、高い収益性が見込めるのかどうか教えてください。
- [A] 今年度取り込めた部分は、ネットワーク向けが中心。Q4 時点では、電子事業の売上の 10%弱を占めると見込んでいる。ハイパースケーラー等の大手顧客から ASIC 向けの引き合いや開発が進んでおり、2026 年度には 10%超になると予測している。
- また、技術面では、大型化・高多層化に加え、パワーデリバリー対応として部品内蔵化が見込まれるため高い収益性が期待できると考えている。
- ^{*1}：ASIC … Application Specific Integrated Circuit (特定用途向け集積回路)

- [Q] 説明会資料 p15 の 2026 年度設備投資金額が、5 月時点から増加したように見えるが、何が増加したのか？
- [A] 今年 5 月の本決算説明会で「2025～2027 年度は平均 1,000 億円水準の設備投資が必要になる」と説明した。その見通しに変更はなく、2026 年度の設備投資金額は、1,000 億円程度になると見込んでいる。
- [Q] 大野工場への設備投資によって、AI や ASIC 向けの SAP キャパシティは、2027 年度末時点でどの程度増加するのか教えてください。
- [A] 2024 年度上期末を 1.0 とした場合、2027 年度末には 2 倍強になる見込み。
- [Q] 河間工場について、5 月時点では、CPU 大手顧客以外も含めて検討していると説明があったが、現在は、CPU 大手顧客向けに進めていくという理解で良いか？
- [A] CPU 大手顧客の需要が強くなってきているのは事実だが、1 本に絞ったわけではなく、他の顧客との話し込みも継続している。

< 質問者 2 >

- [Q] AI サーバー向け IC パッケージ基板における競争環境について、現時点でどのように変化しているか？また、次世代製品の量産時期や製品の付加価値について教えてください。
- [A] 当社のシェアは、70～80%程度と見ている。
- また、今年度は現世代の製品が主力となる見込み。次世代製品は、大型化・高多層化が見込まれるため、それに見合った価格を設定する。
- [Q] 材料調達の面で、どのような問題があるか？新規サプライヤーの認定や量産適用のタイミングについて教えてください。
- [A] 材料調達においては、現在代替サプライヤーの認定を進めている。既に 1 社は認定し、使用開始しているが、キャパシティの面で不安が残るため、引き続き、認定作業を進めていく。
- [Q] 需給ひっ迫の状況下で、製品価格を上昇させられる可能性はあるか？
- [A] 需給がタイトですが、競合他社もキャパシティを増強してくる可能性があり、製品価格については楽観視していません。競争原理が働くとの考えから、価格下落リスクも考慮した中期業績の組立て

となっています。

<質問者 3>

[Q] 価格面について、PC(パソコン)向け・汎用サーバー向け・AI サーバー向け、それぞれどのような動きを想定しているのか教えてほしい。

[A] PC 向け・汎用サーバー向けについては、競争環境を踏まえ、価格下落リスクを保守的に見積もっています。AI サーバー向けは、供給者が限られているため、プラス要因があるかもしれないが、全体としては慎重な見通しを立てている。

[Q] ハイエンド領域における当社の優位性や今後の戦略について教えてほしい。

[A] ASIC やネットワーク向けにおいては、現世代からの参入は難しいが、次世代以降では、技術的なアドバンテージを活かし、参入できる余地が十分あると考えている。特に、部品内蔵技術など、当社が強みを発揮できる分野において、顧客からの期待も高く、十分利益が出る価格帯で交渉を進めている。

<質問者 4>

[Q] IC パッケージ基板の大型化・高多層化が進む中で、生産性を改善することは非常に重要だと考える。大野工場は、従来工場と比べ、どの程度改善できているのか？また、建屋の残り半分に設備を導入していくセカンドフェーズにおいても、追加的な改善が見込めるのか教えてほしい。

[A] 大野工場は、世界最先端の技術を導入しており、生産性というより歩留りの改善が期待できる。すでに実績も出始めている。次の投資についても、可能な限り改善を施したいが、大きく新技術を導入することは時間的に難しいと考える。

[Q] CPU 大手顧客向けビジネスについて、以前よりも前進した印象を受けたが、半年間にどのような変化があったのか、可能な範囲で教えてほしい。

[A] 大型化が進む中で、現在主流の 2.5D パッケージ構造は実装や組み立ての難易度が上がるため、同社が推奨する新技術への関心が高まっている。そうした背景が影響していると考える。

<質問者 5>

[Q] 説明会資料 p11 の AI サーバー向け基板の生産負荷(27 年、2.5 倍)について、さらにアップサイドの可能性はないか教えてほしい。

[A] 資料に記載している倍率は、現時点で顧客と共有している技術ロードマップに基づくもの。今後、何らかの変化があれば、倍率が変わる可能性はある。

<質問者 6>

[Q] 2027 年度までに河間工場の準備を計画すると説明があったが、中期業績に含まれているか？また、かなり大きな設備投資になると思うが、資金面はどう手当てするのか？

[A] 顧客と協議・交渉中につき、現在開示している中期業績見通しには、河間工場からのアウトプットは含めていない。資金面については、あらゆる方法を視野に入れ顧客と協議を進めていきたい。

以上